

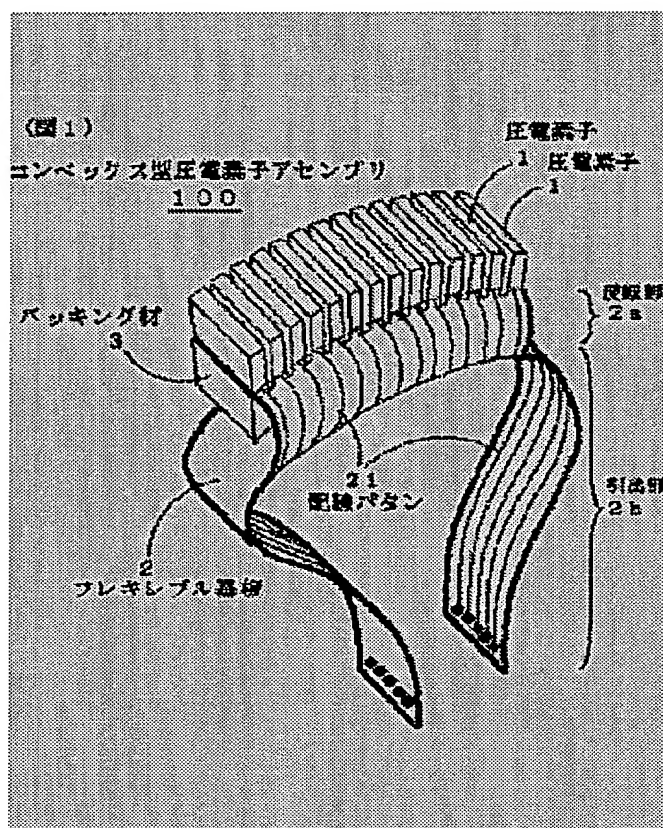
CONVEX TYPE PIEZOELECTRIC ELEMENT ASSEMBLY, METHOD OF MANUFACTURING THE SAME, AND FLEXIBLE BOARD FOR CONVEX TYPE PIEZOELECTRIC ELEMENT ASSEMBLY

Patent number: JP2002052024
Publication date: 2002-02-19
Inventor: SAWAHATA REI
Applicant: GE MED SYS GLOBAL TECH CO LLC
Classification:
- International: A61B8/00; H01L41/09; H01L41/08; H01L41/18; H01L41/187; H01L41/193; H04R17/00; H04R31/00
- european:
Application number: JP20000240329 20000808
Priority number(s): JP20000240329 20000808

Report a data error here

Abstract of JP2002052024

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the manufacturing man-hours and to improve an yield by dispensing with the formation of a slit on a flexible board 2 in advance. **SOLUTION:** This convex-type piezoelectric element assembly 100 comprises a number of piezoelectric elements 1 arranged in the shape of a circular arc, a flexible board 2 connected to a recessed face side of a circular arc arrangement of the piezoelectric elements 1, and a backing material 3 supporting a number of piezoelectric elements 1 through the flexible board 2. The flexible board 2 has reversing parts 2a extended in the direction perpendicular to the arrangement direction of the piezoelectric elements 1 respectively from each part between the piezoelectric element 1 and the backing material 3, and curved at an angle of 80 deg. to be rolled into a rear side of the backing material 3, and leading parts 2b extended in the arrangement direction of the piezoelectric elements 1 from the rear side of the backing material 3 to be connected with a cable (not shown in a drawing).



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-52024

(P2002-52024A)

(43) 公開日 平成14年2月19日 (2002.2.19)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード*(参考)		
A 6 1 B	8/00	A 6 1 B	8/00	4 C 3 0 1	
H 0 1 L	41/09	H 0 4 R	17/00	3 3 0 H	5 D 0 1 9
	41/08			3 3 2 Y	
	41/18		31/00	3 3 0	
	41/187	H 0 1 L	41/08	C	
審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 10 頁) 最終頁に続く					

(21) 出願番号 特願2000-240329 (P2000-240329)

(22) 出願日 平成12年8月8日 (2000.8.8)

(71) 出願人 300019238

ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー

アメリカ合衆国・ウィスコンシン州・

53188・ワウケシャ・ノース・グランドヴ

ュー・プールバード・ダブリュー・710・

3000

(74) 代理人 100095511

弁理士 有近 紳志郎

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 コンベックス型圧電素子アセンブリ、コンベックス型圧電素子アセンブリの製造方法およびコンベックス型圧電素子アセンブリ用フレキシブル基板

(57) 【要約】

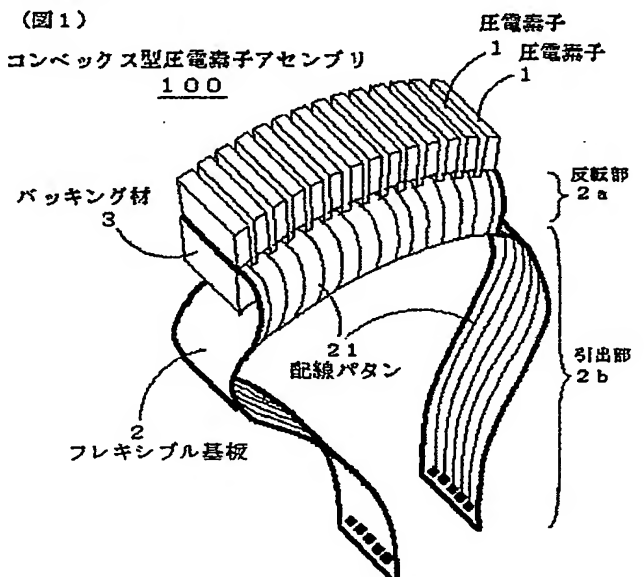
【課題】 製造工数を低減すると共に歩留まりを向上する。

【解決手段】 コンベックス型圧電素子アセンブリ 100 は、円弧状に配列された多数の圧電素子 1 と、それら圧電素子 1 の円弧状配列の凹面側に接続されたフレキシブル基板 2 と、そのフレキシブル基板 2 を介して多数の圧電素子 1 を支持するバックリング材 3 とを備えている。フレキシブル基板 2 は、圧電素子 1 とバックリング材 3 の間から圧電素子 1 の配列方向と直交する方向に延出し 180° 曲がってバックリング材 3 の裏側に回り込む反転部 2a と、ケーブル (図示せず) との接続のためにバックリング材 3 の裏側から圧電素子 1 の配列方向に延びる引出部 2b とを具備している。

【効果】 予めフレキシブル基板 2 にスリットを設けておく必要がなくなり、製造工数を低減できると共に歩留まりを向上できる。

(図 1)

コンベックス型圧電素子アセンブリ 100



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 円弧状に配列された多数の圧電素子と、それら圧電素子の円弧状配列の凹面側に接続されたフレキシブル基板と、そのフレキシブル基板を介して前記多数の圧電素子を支持するバックリング材とを備えたコンベックス型圧電素子アセンブリであって、前記フレキシブル基板は、圧電素子とバックリング材の間から圧電素子の配列方向と交差する方向に延出し 180° 曲がってバックリング材の裏側に回り込む反転部と、バックリング材の裏側から圧電素子の配列方向に延びる引出部とを具備してなることを特徴とするコンベックス型圧電素子アセンブリ。

【請求項 2】 第 1 方向に延びる第 1 部分および第 1 方向とは異なる第 2 方向に延びる第 2 部分を備えたフレキシブル基板の第 1 部分の表側に圧電基板の長手方向を第 2 方向に向けて圧電基板を積層し、フレキシブル基板の裏側にバックリング材の長手方向を第 2 方向に向けてバックリング材を積層し、圧電基板に切込みを入れて第 2 方向に並ぶ多数の圧電素子を形成し、圧電素子とバックリング材の間から第 1 方向に延出している第 1 部分を 180° 曲げてバックリング材の裏側に第 2 部分を回り込ませ、バックリング材の裏側が凹面になるようにバックリング材およびそれに重なるフレキシブル基板の部分を円弧状に曲げることを特徴とするコンベックス型圧電素子アセンブリの製造方法。

【請求項 3】 第 1 方向に延びる第 1 部分および第 1 方向とは異なる第 2 方向に延びる第 2 部分を備えたコンベックス型圧電素子アセンブリ用フレキシブル基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、圧電素子アセンブリ、コンベックス型圧電素子アセンブリの製造方法およびコンベックス型圧電素子アセンブリ用フレキシブル基板に関し、さらに詳しくは、製造工数を低減できると共に歩留まりを向上できる圧電素子アセンブリ、コンベックス型圧電素子アセンブリの製造方法およびコンベックス型圧電素子アセンブリ用フレキシブル基板に関する。

【0002】

【従来の技術】 図 8 は、従来のコンベックス型圧電素子アセンブリの一例の構成説明図である。このコンベックス型圧電素子アセンブリ 800 は、円弧状に配列された多数の圧電素子 1 と、それら圧電素子 1 の円弧状配列の凹面側に接続されたフレキシブル基板 80 と、そのフレキシブル基板 80 を介して多数の圧電素子 1 を支持するバックリング材 3 とを備えている。

【0003】 前記フレキシブル基板 80 は、圧電素子 1 とバックリング材 3 の間から圧電素子 1 の配列方向と交差する方向に延出し、ケーブル（図示せず）との接続のために 90° 曲げられている。また、フレキシブル基板 80 には、配線ボタン 81 およびスリット 82 が設けられ

ている。これら配線ボタン 81 およびスリット 82 は、圧電素子 1 およびバックリング材 3 と積層する前に予め設けられる。

【0004】 次に、図 9～図 11 を参照して、上記コンベックス型圧電素子アセンブリ 800 の製造方法を説明する。図 9 に示すように、フレキシブル基板 80 のスリット 82 を入れた端部の表側に圧電基板 10 を積層し、裏側にバックリング材 3 を積層する。次に、図 10 に示すように、ダイシングにより圧電基板 10 に切込み 11 を入れ、多数の圧電素子 1 を形成する。次に、図 11 に示すように、圧電素子 1 およびバックリング材 3 の間から出たフレキシブル基板 80 を 90° 曲げる。最後に、図 8 に示したように、バックリング材 3 の裏側が凹面になるようにバックリング材 3 およびそれに重なるフレキシブル基板 80 の部分を円弧状に曲げる。

【0005】 フレキシブル基板 80 にスリット 82 を設ける理由は、フレキシブル基板 80 が 90° 曲がっているため、スリット 82 が無いと、バックリング材 3 およびそれに重なるフレキシブル基板 80 の部分を円弧状に曲げられなくなるからである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 上記従来のコンベックス型圧電素子アセンブリ 800 では、予めフレキシブル基板 80 にスリット 82 を設けておく必要があった。しかし、多数（例えば 127 本）のスリット 82 を設けるには、製造工数がかかる問題点がある。また、非常に狭いピッチ（例えば 1 mm）の配線ボタン 81 の間にスリット 82 を設けるため、少しの誤差で不良品が出て、歩留まりが下がる問題点がある。そこで、本発明の目的は、製造工数を低減できると共に歩留まりを向上できるコンベックス型圧電素子アセンブリ、当該コンベックス型圧電素子アセンブリの製造方法および当該コンベックス型圧電素子アセンブリの使用するフレキシブル基板を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】 第 1 の観点では、本発明は、円弧状に配列された多数の圧電素子と、それら圧電素子の円弧状配列の凹面側に接続されたフレキシブル基板と、そのフレキシブル基板を介して前記多数の圧電素子を支持するバックリング材とを備えたコンベックス型圧電素子アセンブリであって、前記フレキシブル基板は、圧電素子とバックリング材の間から圧電素子の配列方向と交差する方向に延出し 180° 曲がってバックリング材の裏側に回り込む反転部と、バックリング材の裏側から圧電素子の配列方向に延びる引出部とを具備してなることを特徴とするコンベックス型圧電素子アセンブリを提供する。上記第 1 の観点によるコンベックス型圧電素子アセンブリでは、圧電素子およびバックリング材の間から延出したフレキシブル基板が、90° 曲がるのではなく、180° 曲がってバックリング材の裏側に回り込んでいる。

このため、スリットが無くても、バックング材 3 およびそれに重なるフレキシブル基板の部分を円弧状に曲げることが出来る。よって、予めフレキシブル基板にスリットを設けておく必要がなくなり、製造工数を低減できると共に歩留まりを向上できる。

【0008】第 2 の観点では、本発明は、第 1 方向に延びる第 1 部分および第 1 方向とは異なる第 2 方向に延びる第 2 部分を備えたフレキシブル基板の第 1 部分の表側に圧電基板の長手方向を第 2 方向に向けて圧電基板を積層し、フレキシブル基板の裏側にバックング材の長手方向を第 2 方向に向けてバックング材を積層し、圧電基板に切込みを入れて第 2 方向に並ぶ多数の圧電素子を形成し、圧電素子とバックング材の間から第 1 方向に延出している第 1 部分を 180° 曲げてバックング材の裏側に第 2 部分を回り込ませ、バックング材の裏側が凹面になるようにバックング材およびそれに重なるフレキシブル基板の部分を円弧状に曲げることの特徴とするコンベックス型圧電素子アセンブリの製造方法を提供する。上記第 2 の観点によるコンベックス型圧電素子アセンブリの製造方法では、上記第 1 の観点によるコンベックス型圧電素子アセンブリを好適に製造できる。

【0009】第 3 の観点では、本発明は、第 1 方向に延びる第 1 部分および第 1 方向とは異なる第 2 方向に延びる第 2 部分を備えたコンベックス型圧電素子アセンブリ用フレキシブル基板を提供する。上記第 3 の観点によるコンベックス型圧電素子アセンブリ用フレキシブル基板は、上記第 1 の観点によるコンベックス型圧電素子アセンブリに好適に使用できる。

【0010】

【発明の実施の形態】以下、図に示す実施の形態により本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本発明が限定されるものではない。図 1 は、本発明の一実施形態に係るコンベックス型圧電素子アセンブリの斜視図である。このコンベックス型圧電素子アセンブリ 100 は、円弧状に配列された多数の圧電素子 1 と、それら圧電素子 1 の円弧状配列の凹面側に接続されたフレキシブル基板 2 と、そのフレキシブル基板 2 を介して多数の圧電素子 1 を支持するバックング材 3 とを備えている。

【0011】前記フレキシブル基板 2 は、圧電素子 1 とバックング材 3 の間から圧電素子 1 の配列方向と直交する方向に延出し 180° 曲がってバックング材 3 の裏側に回り込む反転部 2a と、ケーブル（図示せず）との接続のためにバックング材 3 の裏側から圧電素子 1 の配列方向に延びる引出部 2b とを具備している。また、フレキシブル基板 2 には、配線パターン 21 が設けられている。この配線パターン 21 は、圧電素子 1 およびバックング材 3 と積層する前に予め設けられる。また、配線パターン 21 をフレキシブル基板 2 の両面に設けてもよい。

【0012】前記圧電素子 1 は、PZT セラミックスのような圧電セラミックス、または、ポリフッ化ビニリデ

ン (PVDF) などの圧電高分子 C 子、または、水晶、ロッシェル塩などから構成される。

【0013】前記バックング材 3 は、天然ゴム、フェライトゴム、エポキシ樹脂に酸化タングステンや酸化チタンの粉末を入れてプレス成形したものなどの高減衰材料、または、塩化ビニル、ポリビニルブチラール (PUB)、ABS 樹脂、ポリウレタン (PUR)、ポリビニルアルコール (PUAL)、ポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP)、ポリアセタール (POM)、ポリエチレンテレフタレート (PETP)、フッ素樹脂 (PTFE)、ポリエチレングリコール、ポリエチレンテレフタレート-ポリエチレングリコール共重合体などの熱可塑性樹脂から構成される。

【0014】図 2 は、上記コンベックス型圧電素子アセンブリ 100 の断面図（圧電素子 1 と圧電素子 1 の間で切断）である。フレキシブル基板 2 の配線パターン 21 は、圧電素子 1 の電極 11 と接続している。

【0015】次に、図 3～図 7 を参照して、上記コンベックス型圧電素子アセンブリ 100 の製造方法を説明する。図 3 に示すように、フレキシブル基板 2 は、第 1 方向に延びる第 1 部分 2A および第 1 方向とは直交する第 2 方向に延びる第 2 部分 2B を備えた T 字形をしている。その第 1 部分 2A の端部の表側に圧電基板 10 を積層し、裏側にバックング材 3 を積層し、図 4 に示すように一体化する。なお、フレキシブル基板 3 を T 字形とすることで引出部 2b を 2 方向に延ばすことが出来るため、配線パターン 21 を引き出しやすくなる利点がある。ただし、これに限定されず、フレキシブル基板 3 を L 字形としてもよい。

【0016】次に、図 5 に示すように、ダイシングにより圧電基板 10 に切込み 11 を入れ、多数の圧電素子 1 を形成する。次に、図 6 に示すように、圧電素子 1 およびバックング材 3 の間から出たフレキシブル基板 2 の第 1 部分 2A を 180° 曲げ、第 2 部分 2B をバックング材 3 の裏側に合わせる。次に、図 7 に示すように、バックング材 3 の裏側が凹面になるようにバックング材 3 およびそれに重なるフレキシブル基板 2 の部分を円弧状に曲げる。以上により、図 1 に示したコンベックス型圧電素子アセンブリ 100 が得られる。

【0017】

【発明の効果】本発明のコンベックス型圧電素子アセンブリ、コンベックス型圧電素子アセンブリの製造方法およびコンベックス型圧電素子アセンブリ用フレキシブル基板によれば、予めフレキシブル基板にスリットを設けておく必要がなくなり、製造工数を低減できると共に歩留まりを向上できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の一実施形態にかかるコンベックス型圧電素子アセンブリの斜視図である。

【図 2】図 1 のコンベックス型圧電素子アセンブリの断

面図である。

【図3】本発明の一実施形態にかかるコンベックス型圧電素子アセンブリ用フレキシブル基板の斜視図である。

【図4】図1のコンベックス型圧電素子アセンブリの製造過程のうち、圧電基板およびバックリング材の積層過程を示す斜視図である。

【図5】図1のコンベックス型圧電素子アセンブリの製造過程のうち、ダイシング過程を示す断面図である。

【図6】図1のコンベックス型圧電素子アセンブリの製造過程のうち、フレキシブル基板の180°曲げ過程を示す断面図である。

【図7】図1のコンベックス型圧電素子アセンブリの製造過程のうち、バックリング材およびフレキシブル基板の円弧曲げ過程を示す断面図である。

【図8】従来のコンベックス型圧電素子アセンブリの一例を示す構成説明図である。

【図9】図8のコンベックス型圧電素子アセンブリの製造過程のうち、圧電基板およびバックリング材の積層過程

を示す斜視図である。

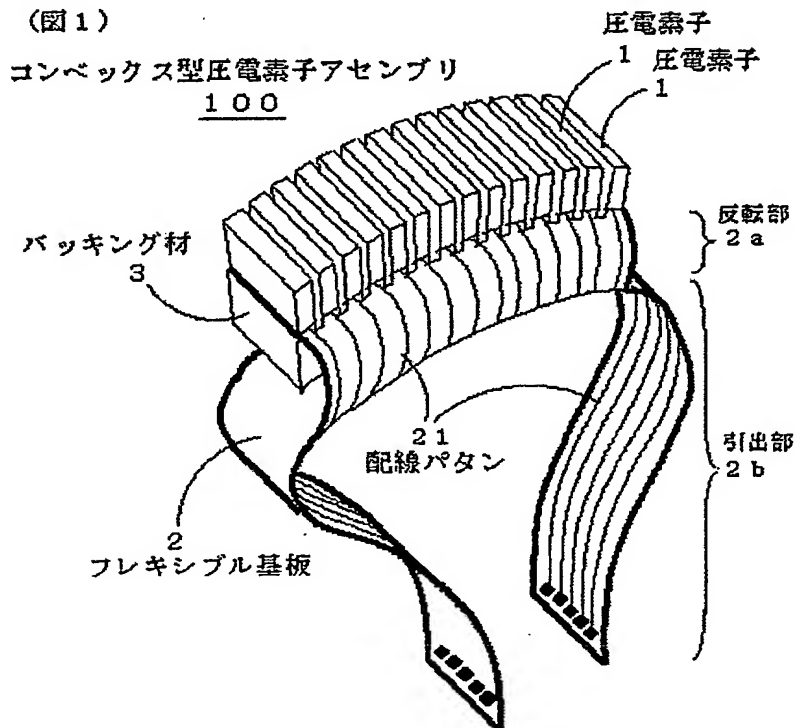
【図10】図8のコンベックス型圧電素子アセンブリの製造過程のうち、ダイシング過程を示す断面図である。

【図11】図8のコンベックス型圧電素子アセンブリの製造過程のうち、フレキシブル基板の90°曲げ過程を示す断面図である。

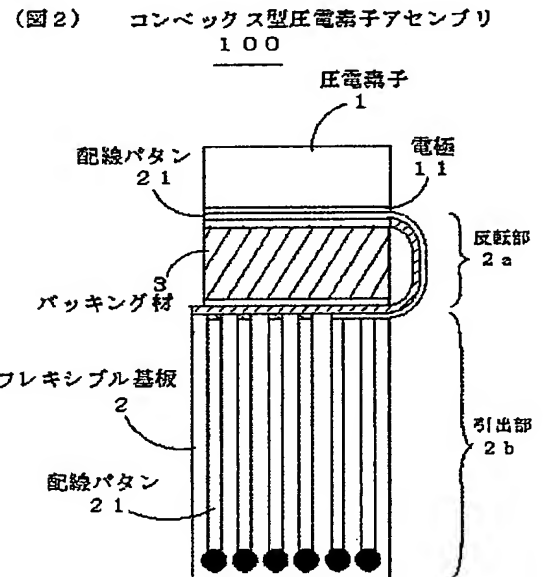
【符号の説明】

100	コンベックス型圧電素子アセンブリ
1	圧電素子
2	フレキシブル基板
2a	反転部
2A	第1部分
2b	引出部
2B	第2部分
11	切込み
21	配線パターン
3	バックリング材

【図1】

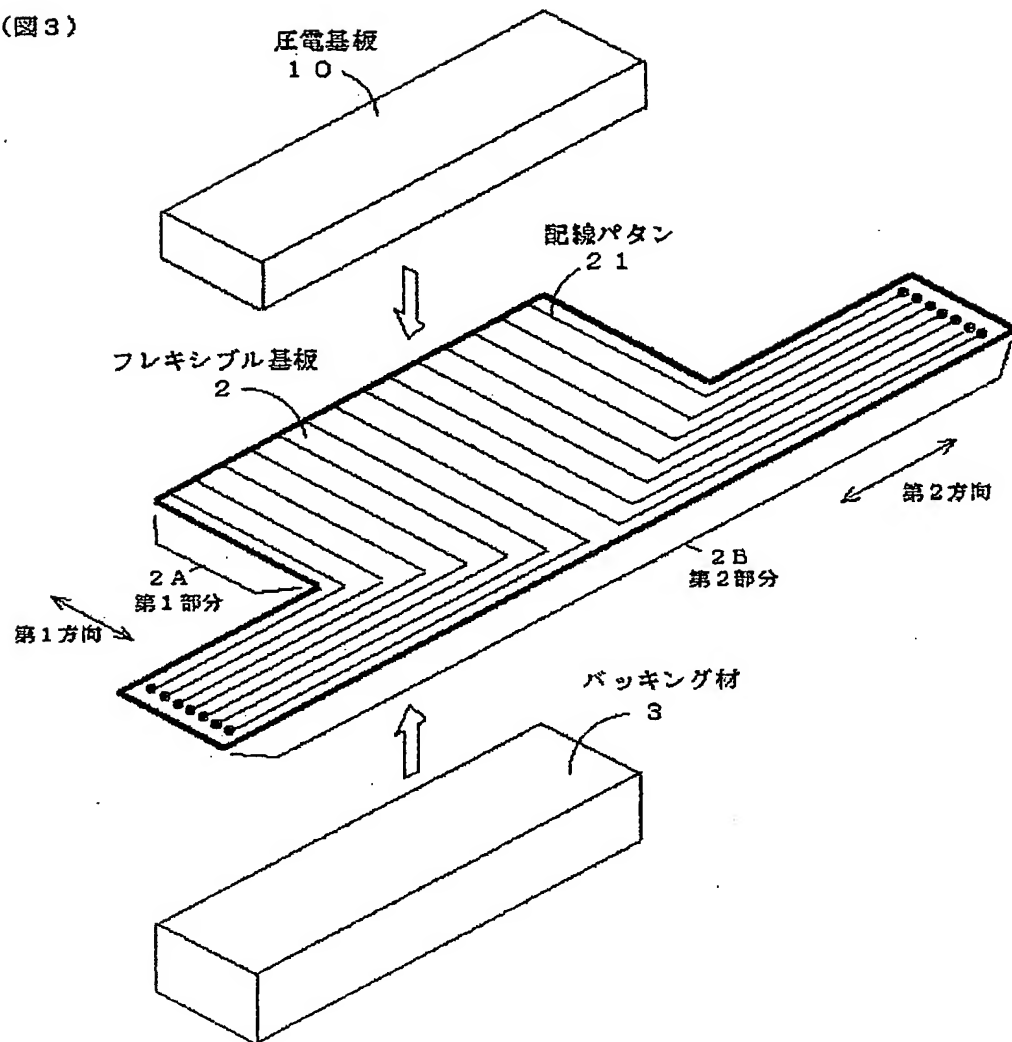


【図2】

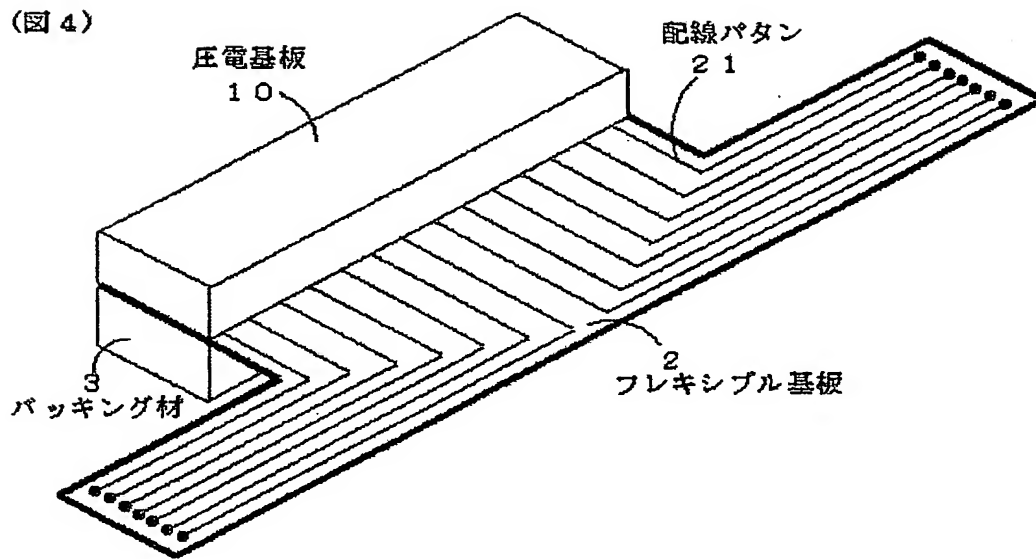


【図3】

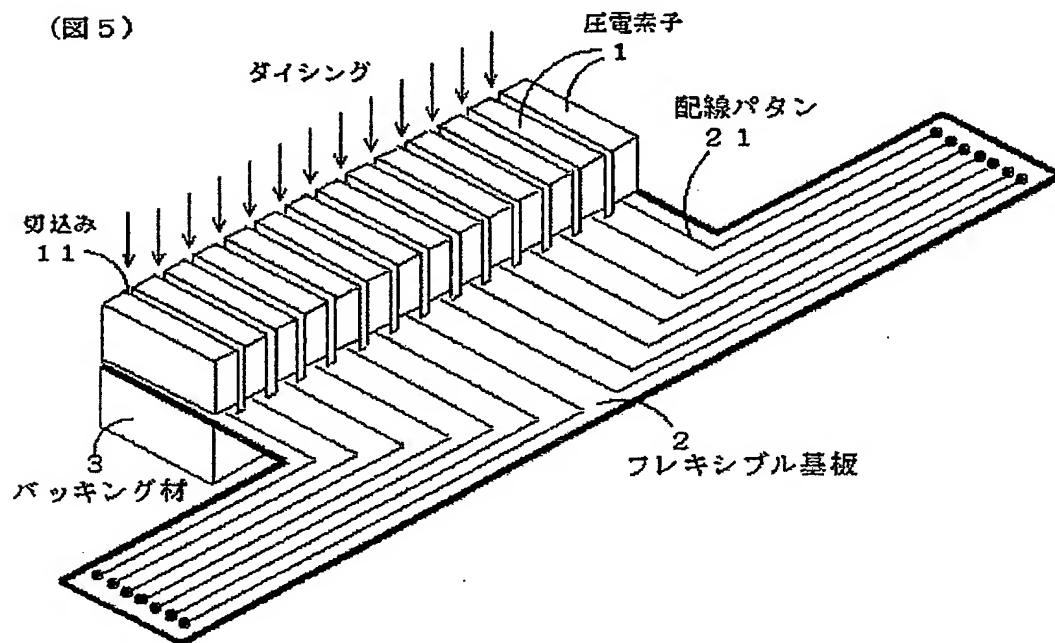
(図3)



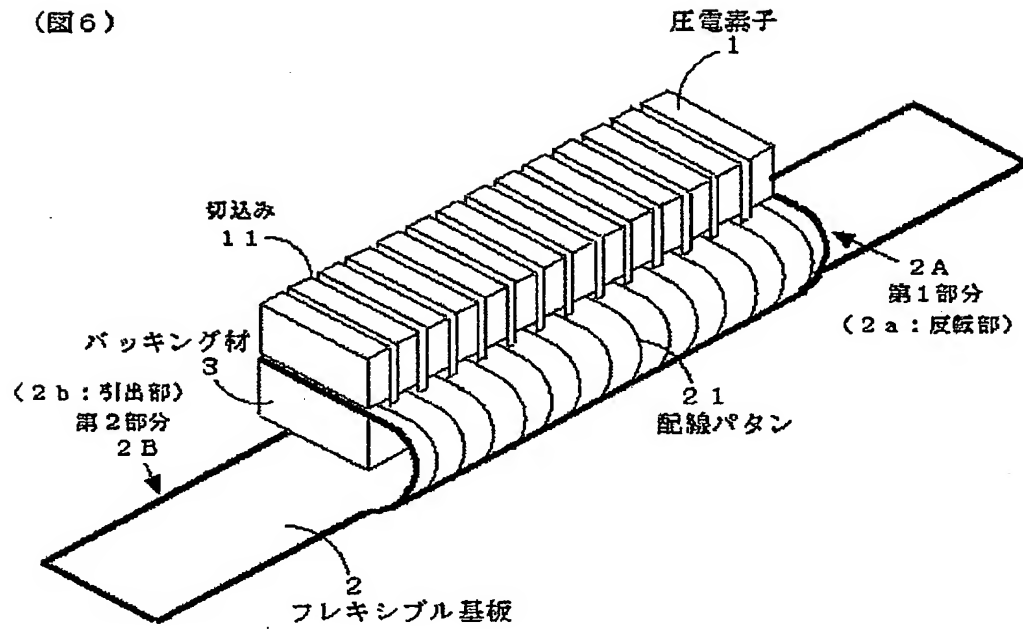
【図4】



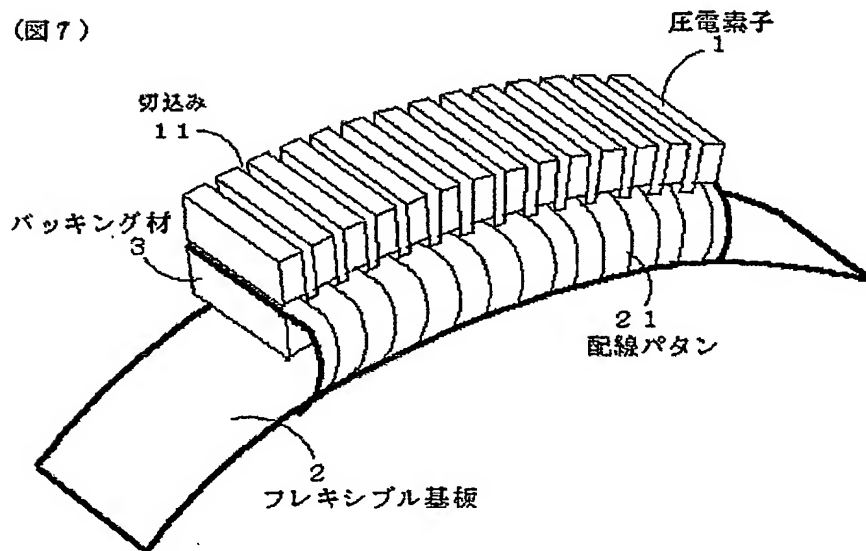
【図5】



【図6】

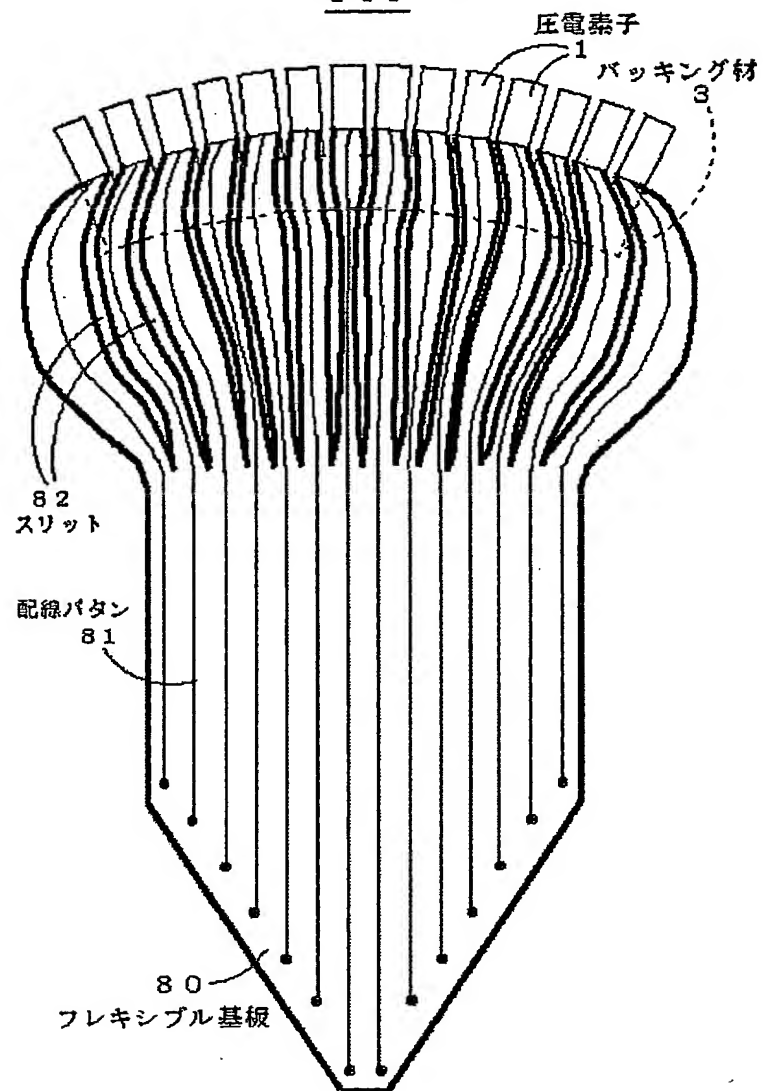


【図7】

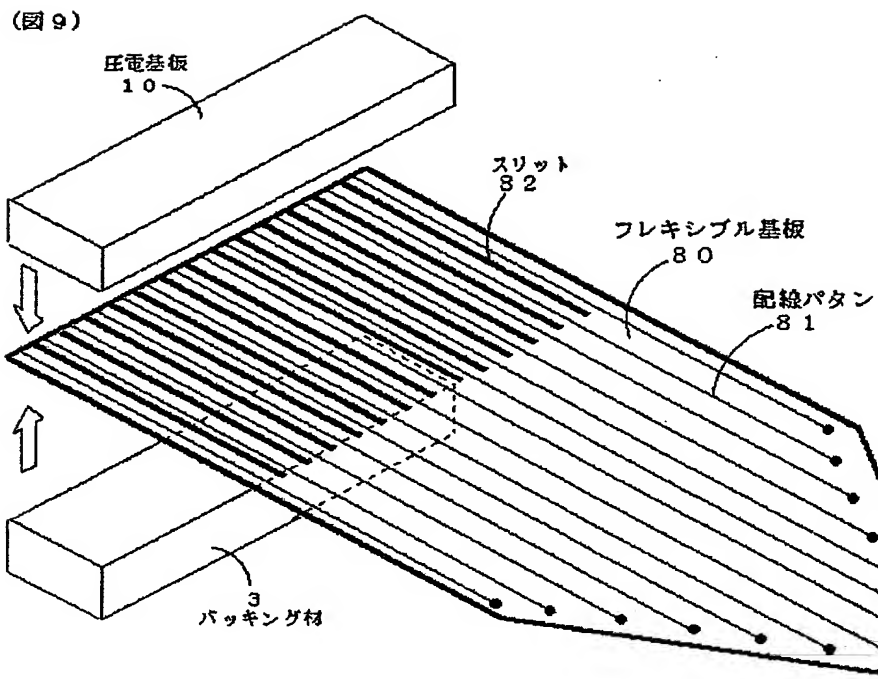


【図8】

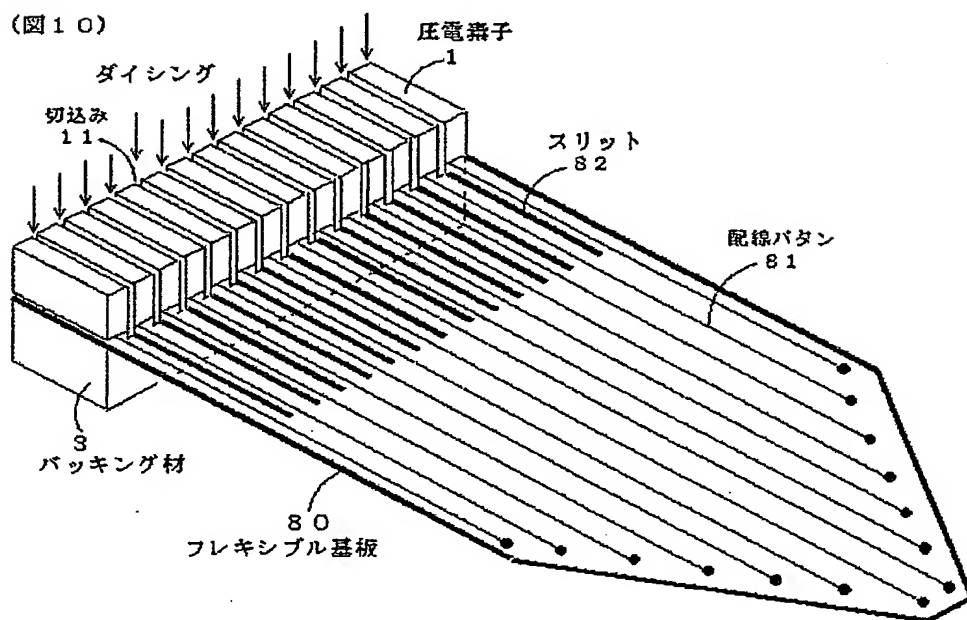
(図8) コンベックス型圧電素子アセンブリ
800



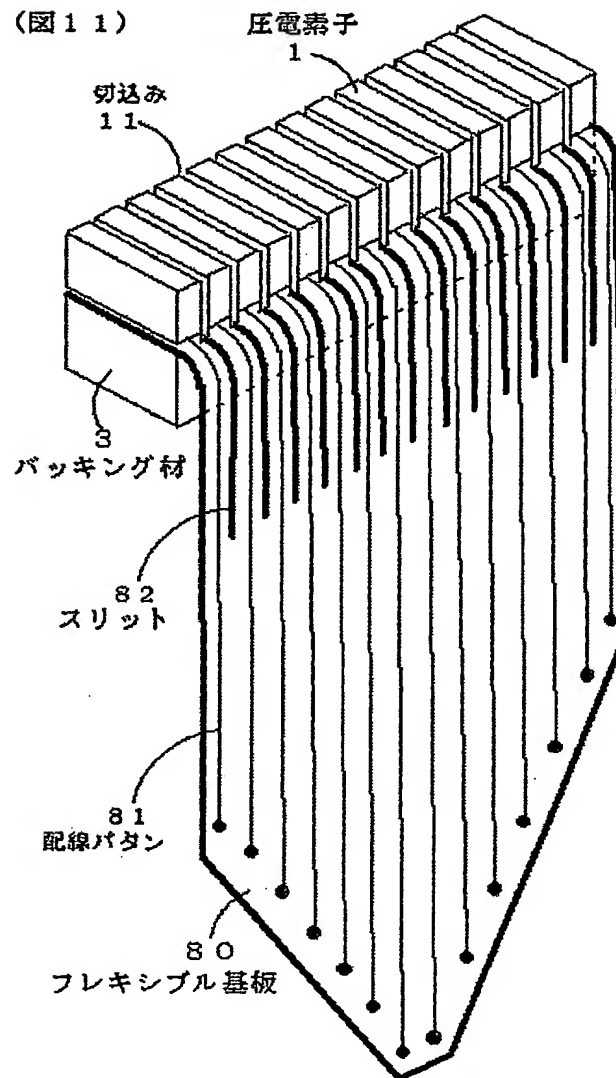
【図9】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テーム (参考)
H 0 1 L 41/193		H 0 1 L 41/08	H
H 0 4 R 17/00	3 3 0	41/18	1 0 1 A
	3 3 2		1 0 1 D
31/00	3 3 0		1 0 2

(72) 発明者 澤畑 玲
東京都日野市旭ヶ丘4丁目7番地の127
ジーイー横河メディカルシステム株式会社
内

F ターム (参考) 4C301 EE17 EE20 GB06 GB19 GB20
GB33 GB40
5D019 AA26 BB02 BB04 BB18 BB26
BB28 FF04 GG06 GG09 HH01